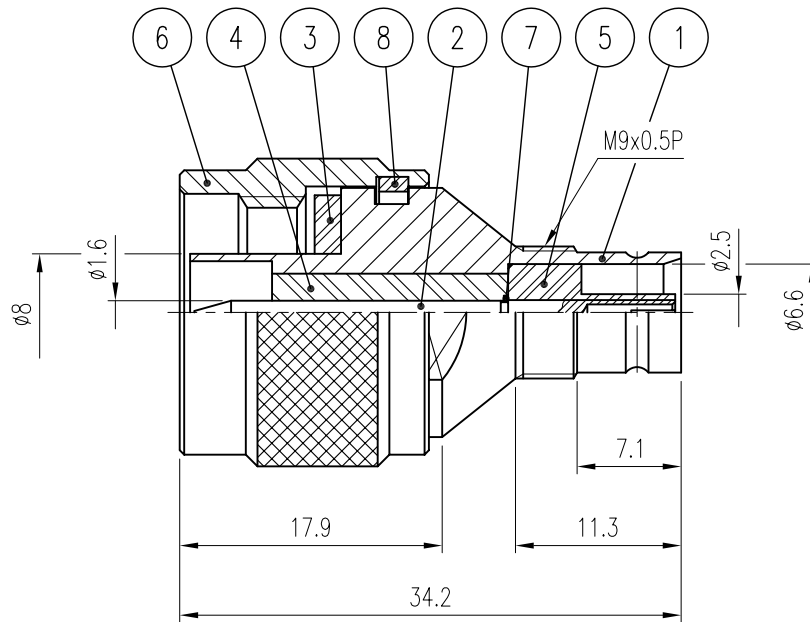


수 정 내 용										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(가공)														
ST(기준)														
ST(개선)														



8	SPRING RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR000200-135/1 (R8001)
7	고정 RING	1	TEFLON		DSR00040-15/1 (LA005)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00059-15/1 (K8008)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00521-N/1 (HA095)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01027-N/1 (HA094)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00013-N/1 (G8001)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00064-1345/1 (EA077)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00066-135/1 (DA077)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2000. 2. 22.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. 도명 SMAP-TNCJ				
	승인						
재질	검도				도명 SMAP-TNCJ		
	재도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 AD00124-7/1	
보호피막처리	적도 NS	단위 mm	총량			K361-790-000	